

# tesa HAF® 8410 HS

## Information Produit

Film adhésif structurel réactif ambré de 60 µm



## Description produit

tesa HAF® 8410 est un film réactif thermocollant à base de résine phénolique et de caoutchouc nitrile. Cette bande adhésive double face ambrée ne comporte pas de support. Elle est protégée par un protecteur papier résistant et peut être facilement découpée ou flambée.

Elle est activée par la chaleur et la pression appliquées pendant une certaine durée.

## Caractéristiques

- Collage fiable des modules à puce
- Convient aux cartes en PVC, ABS, PET et PC
- Bonne maniabilité sur toutes les lignes d'implantation courantes
- Excellente résistance au vieillissement
- Flexibilité à vie grâce à la forte teneur en caoutchouc

## Application

tesa HAF® 8410 est spécialement conçue pour l'implantation de modules à puce dans les cartes à puce. Elle convient également pour le collage de tous les matériaux résistants à la chaleur, tels que le métal, le verre, le plastique, le bois et les textiles (par exemple, des garnitures de friction pour embrayages).

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                                          |                    |       |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | aucun                                    | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc nitrile/<br>résine phénolique | • Couleur          | ambre |
| • Type de protecteur     | glassine                                 |                    |       |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                            |                      |                                           |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| • Pouvoir adhésif (cisaillement dynamique) | 12 N/mm <sup>2</sup> | • Pouvoir adhésif (par poussée verticale) | 12 N/mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|

## Infos complémentaires

Recommandations techniques pour les applications de cartes à puce :

tesa HAF® 8410 n'est pas auto-adhésif. Il est activé par la chaleur et la pression sur un certain intervalle. Les valeurs suivantes sont des recommandations pour les paramètres machines pour commencer. Veuillez noter que les paramètres

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=8410>

# tesa HAF® 8410 HS

## Information Produit

### Infos complémentaires

optimaux dépendent fortement du type de machine, des matériaux particuliers des corps de la carte et des modules à puce, ainsi que des exigences du client.

#### 1. Pré-laminage :

Lors du pré-laminage, la bande adhésive est laminée sur la bande de modules. L'étape de pré-laminage n'influence pas la durée de vie de la bande. Les bandes pré-laminées peuvent être stockées pendant la même période que la bande adhésive.

Réglage de la machine :

- Température : 120–140 °C
- Pression : 2–3 bar
- Temps : 2,5 m/min

#### 2. Implantation du module :

Pendant l'implantation, les modules pré-laminés sont découpés de la bande, positionnés dans la cavité de la carte puis collés définitivement au corps de la carte par la chaleur et la pression. Selon le type de ligne d'implantation, un processus en une ou plusieurs étapes est possible. Aujourd'hui, la plupart des machines utilisent plusieurs étapes de pressage à chaud.

Processus en une seule étape – Réglage de la machine :

- Température<sup>1</sup> : 180–200 °C
- Pression : 65–75 N/module
- Temps : 1,5 s

Processus en plusieurs étapes – Réglage de la machine :

- Température<sup>1</sup> : 180–200 °C
- Pression : 65–75 N/module
- Temps : 2 x 0,7 s / 3 x 0,5 s

<sup>1</sup> Température mesurée à l'intérieur de la tête chauffante. Différents réglages de température sont recommandés selon les matériaux de la carte :

PVC et ABS : 180–190 °C

PET et PC : 190–200 °C

Les valeurs de résistance du collage ont été obtenues dans des conditions de laboratoire standards. La valeur est la limite de spécification vérifiée pour chaque lot de production (matériau : éprouvette en aluminium gravé / conditions de collage : température = 120 °C ; pression = 10 bar ; temps = 8 min). Pour atteindre une résistance de collage maximale, les surfaces doivent être propres et sèches.

# tesa HAF® 8410 HS

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=8410>